



Pasta para Soldar 42gr XGSP50 MECHANIC

Descripción

CARACTERÍSTICAS

- Aplíquese con pincel, directo al dispositivo en reparación.
- Evita la oxidación de las pistas de cobre en circuitos impresos y permite obtener soldaduras brillantes y confiables.
- Durante el soldado, disminuye la tensión superficial del estaño y la temperatura de fusión, evitando el deterioro de componentes, trazas, terminales y conectores en general.
- No sobrecalentar, se puede destruir el flux y el cobre perdería sus propiedades mecánicas.
- Ideal para microelectrónica con soldaduras sin plomo.
- Debe utilizarse en equipos apagados.

VENTAJAS

- Reduce el óxido en los componente y superficies aplicadas.
- Reduce la tensión superficial de la soldadura fundida.
- Ayuda a prevenir la oxidación de la superficie durante y después de la soldadura.

- Mejora la transferencia de calor entre la superficie a soldar, obteniendo así una mejor calidad del trabajo.

ESPECIFICACIONES

MODELO	XGSP50
MARCA	MECHANIC
TIPO	Pasta para Soldar
CONTENIDO	42 gramos
PUNTO DE FUSIÓN	183°C
ALEACIÓN	Estaño 63%/Plomo 37% (Sn63/Pb37)
MICRAS	20-38um

WESTOR.PE